

2010-2015年集成电路封装 用锡球行业深度评估及市场调查研究报告及发展趋势分析报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2010-2015年集成电路封装用锡球行业深度评估及市场调查研究及发展趋势分析报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/dianli1101/6038271ST4.html>

【报告价格】纸介版6800元 电子版7000元 纸介+电子7200元

【出版日期】2024-12-24

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

2010-2015年集成电路封装用锡球行业深度评估及市场调查研究报告 内容介绍

:

1. 概述
2. 锡球的品种及应用
 - 2.1 锡球的品种
 - 2.2 锡球的应用
 - 2.2.1 锡球的主要应用领域
 - 2.2.2 锡球的实际使用
 - 2.2.3 锡球的市场特点
3. 锡球的制造技术
 - 3.1 各种锡球制造工艺法的概述
 - 3.1.1 气雾化法
 - 3.1.2 离心雾化法
 - 3.1.3 切丝重熔法
 - 3.1.4 均匀液滴成型法
 - 3.1.5 几种制造锡球工艺法的分析对比
 - 3.2 切丝重熔法工艺过程及其质量控制
 - 3.2.1 切丝重熔法原理及工艺流程
 - 3.2.2 切丝重熔法制造锡球所需的主要设备
 - 3.2.3 切丝重熔法的技术特点
 - 3.3 气雾化法工艺过程及其质量控制
 - 3.4 均匀液滴成型法的工艺特点及研究开展
 - 3.4.1 均匀液滴成型法的基本原理
 - 3.4.2 利用均匀液滴法生产单分散颗粒的研究现状
 - 3.5 国内锡球制造技术的主要专利介绍
4. 锡球的性能要求
 - 4.1 与锡球相关的标准
 - 4.2 物理、机械性能要求
 - 4.3 锡球关键质量的要求
 - 4.3.1 锡球关键质量指标的主要术语

- 4.3.2 锡球关键质量指标的要求
- 4.3.3 无铅锡球的特殊要求
- 4.4 无铅锡球的主要品种、组成成分及熔融温度
- 4.5 国内外锡球主要性能水平的对比
- 5. 无铅化锡球的发展
 - 5.1 焊料发展的历史
 - 5.2 国内外焊料无铅化的开展情况
 - 5.2.1 国际情况
 - 5.2.2 国内情况
 - 5.3 无铅焊料产品与应用情况
 - 5.3.1 无铅焊料的含铅量的限定
 - 5.3.2 无铅焊料的主要种类及特性
 - 5.4 SN-AG , SN-AG-CU系无铅焊料产品情况
 - 5.4.1 Sn-Ag二元合金焊料
 - 5.4.2 Sn-Ag-Cu三元合金焊料
 - 5.4.3 Sn-Ag、Sn-Ag-Cu系焊料目前存在的问题
 - 5.5 无铅焊料的专利情况
 - 5.5.1 两个在世界上影响力最大的无铅焊料专利
 - 5.5.2 日本千住金属在国外的专利授权公司情况
 - 5.5.3 对无铅焊料知识产权的分析
 - 5.5.4 无铅锡球在制造中的技术难点
- 6. 锡球主要原料——锡材料的供应情况
 - 6.1 锡原料的生产情况
 - 6.2 世界锡消费(锡消费市场调研)市场的分析
 - 6.2.1 锡市场结构分析
 - 6.2.2 2008年锡市场情况
 - 6.2.3 2009年上半年锡市场情况
 - 6.3 国内锡生产、供应情况
- 7. BGA和CSP封装用锡球的市场情况
 - 7.1 IC封装的发展历程
 - 7.2 BGA、CSP等新型半导体封装产品与技术发展
 - 7.3 世界IC封装(IC封装市场调研)市场与产业的发展

7.4 我国半导体封测产业概况及市场

7.4.1 我国集成电路产业的整体现状

7.4.2 我国半导体封测业生产总体情况

7.4.3 我国半导体封测厂商分布及产能情况

7.4.4 2007年我国半导体封测业销售额前30家企业情况

7.4.5 国内主要半导体封装测试企业的情况分述

8. 境外锡球生产现状与发展

8.1 总述

8.2 境外主要生产锡球的厂家

8.2.1. 千住金属工业株式会社

8.2.2 日本斯倍利亚株式会社

8.2.3 减摩合金工业株式会社

8.2.4 日立金属株式会社

8.2.5 新日本制铁株式会社

8.2.6 三菱材料

8.2.7 美国阿尔法材料公司

8.2.8 法国MBO有限公司

8.2.9 台湾业强科技股份有限公司

8.2.10 台湾恒硕科技有限公司

8.2.11 台湾豪岑电子金属股份公司

8.2.12 台湾升贸科技股份有限公司

8.2.13 台湾天翼科技股份有限公司

8.2.14 台湾大瑞科技

8.2.15 新加坡朝日 (ASAHI) 公司

9 . 中国锡球生产现状与(锡球生产现状与市场调研)发展

9.1 总述

9.2 我国国内主要生产锡球的厂家

9.2.1 霸州邦壮电子材料有限公司

9.2.2 安徽精通科技有限公司

9.2.3 江苏大宇宙新电子有限公司

9.2.4 云南锡业股份有限公司

9.2.5 深圳市爱法焊锡制品有限公司

9.2.6 北京达博长城锡焊料有限公司

9.2.7 肯麦特(上海)材料科技有限公司

9.2.8 深圳市云亨焊锡制品有限公司

9.2.9 重庆群威电子材料有限公司

9.2.10 国内其它可生产锡球的企业

图表目录

图表：锡球应用于IC封装BGA (BALL GRID ARRAY)产品示意图

图表：锡球应用于封装主机板及手机产品示意图

图表：切丝重熔法颗粒长度

图表：切丝重熔法焊球直径

图表：切丝重熔法示意图

图表：切丝重熔法工艺流程

图表：切丝重熔法制造锡球试验装置

图表：国内锡球制造技术的主要专利介绍

图表：锡球的合金成分与用途

图表：锡球的生产尺寸与包装

图表：国内外锡球主要性能水平对比

图表：焊料的熔点变化及其金属成份

图表：焊料的杂质和各种特性

图表：焊料杂质的标准值

图表：铅 - 锡焊料中有害杂质含量一览表

图表：可以替代有铅焊料的元素

图表：目前已有无铅焊料系列

图表：无铅焊料及其熔点变化

图表：无铅焊料湿润角

图表：常用锡基二元合金焊料的优缺点

图表：SN-AG-CU合金组织

图表：2009年1-11月天津锡产量统计

图表：2009年1-11月广西锡产量统计

图表：2009年1-11月江西锡产量统计

图表：2009年1-11月浙江锡产量统计

图表：2009年1-9月湖南锡产量统计

图表：2009年1-9月广西锡产量统计
图表：2009年1-9月江西锡产量统计
图表：2009年1-9月浙江锡产量统计
图表：2009年1-8月云南锡产量统计
图表：2009年1-8月福建锡产量统计
图表：2009年1-8月中国锡产量统计
图表：2005—2009年1-11月中国锡粉产量变动情况
图表：2007年度国内IC封装测试企业销售收入排名
图表：国内封装测试企业的地域分布情况
图表：无铅锡线产品分类大致如下：
图表：三菱综合材料株式会社基本信息
图表：江苏大丰宙新电子有限公司发展战略
图表：云南锡业股份有限公司主要产品与服务
图表：云南锡业股份有限公司主营收入变化
图表：云南锡业股份有限公司主营收入变化统计表
图表：云南锡业股份有限公司净利润变化
图表：云南锡业股份有限公司净利润统计表
图表：2004 - 2008年云南锡业股份有限公司各年度财务指标
图表：2008 - 2008年云南锡业股份有限公司各季度财务指标
图表：2009年云南锡业股份有限公司盈利预测
图表：深圳市爱法焊锡制品有限公司公司质量管理
图表：北京达博长城锡焊料有限公司产品介绍
图表：北京达博长城锡焊料有限公司产品规格
图表：深圳市嘉良焊锡制品有限公司基本信息

详细请访问：<http://www.bosidata.com/dianli1101/6038271ST4.html>